

关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券(第二期)簿记建档时间的公告

厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过70亿元（含70亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕623号”文批复。

根据《厦门金圆投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告》，发行人和簿记管理人将于2025年7月9日（T-1日）15:00-18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由2025年7月9日（T-1日）18:00延长至19:00。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于延长“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)”簿记建档时间的公告》之盖章页)

发行人：厦门金圆投资集团有限公司



2025 年 7 月 9 日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于延长“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)”簿记建档时间的公告》之盖章页）

簿记管理人：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《关于延长“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2025年 7 月 9 日

(本页无正文，为《关于延长“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)”簿记建档时间的公告》之盖章页)



华福证券有限责任公司

2025年 7 月 9 日

（本页无正文，为《关于延长“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）



（本页无正文，为《关于延长“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）



（本页无正文，为《关于延长“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）

